

ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT

AP20 Rechtsgutachten 17 FEB 2006

Aufgrund der Eingabe vom 10. September 2003 wurde der Name der Anmelderin richtig gestellt.

Die Richtigstellung des Titels der Anmeldung im Computer ist veranlasst worden.

Sie werden eingeladen, sich innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung dieses Vorbescheides hierüber zu äußern bzw. innerhalb dieser Frist die angeführten Mängel Ihrer Anmeldung zu beheben. Wird innerhalb dieser Frist weder den erteilten Aufträgen entsprochen, noch eine Äußerung oder ein Antrag auf Verlängerung der Frist überreicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Diese Rechtsfolge tritt außer Kraft, wenn binnen vier Monaten nach Ablauf der Frist den erteilten Aufträgen entsprochen (bzw. die Äußerung auf den Vorbescheid nachgeholt) und eine Gebühr im Ausmaß der Anmeldegebühr (50 €) gezahlt wird. Die Gebühr ist auf das Konto des Österreichischen Patentamts (PSK Kto. Nr. 5 160 000; BLZ 60 000) zu überweisen bzw. einzuzahlen.

Als Verwendungszweck ist Folgendes anzuführen:

A 1415/2003 Nachfristgebühr.

Der Antrag auf Verlängerung der Frist unterliegt einer Verfahrensgebühr in der Höhe von 12 €. Die Gebühr ist auf das Konto des Österreichischen Patentamtes zu überweisen bzw. einzuzahlen. Als Verwendungszweck ist Folgendes anzuführen:

A 1415/2003 Fristgesuch.

Der Antrag auf Verlängerung der Frist unterliegt einer Schriftengebühr gemäß Gebührengesetz, die bei Abschluss des Anmeldeverfahrens auf Aufforderung einzuzahlen ist.

In der Beilage wird Ihnen ein Formular für die erste Seite einer Patentanmeldung - PA 3 I (zweifach) übermittelt.

Österreichisches Patentamt
Technische Abteilung 3C

Wien, am 25. August 2004

Dipl.-Ing. MESA PASCASIO

ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT
~~AP2010000001370 17 FEB 2006~~

Dresdner Straße 87, 1200 Wien (Postfach 95)
Telefon: 01/53424 (FAX DW 535)

PSK Konto Nr. 5 160 000
BLZ 60 000

Ihr Zeichen: R 41603

An
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM-
TECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT
zu Handen
SONN & PARTNER PATENTANWÄLTE
WIEN

Geschäftszahl: 3C A 1415/2003 - 1,2
(bitte immer anführen - ermöglicht die Zuordnung Ihrer Eingaben!)

IPC: H05K

Anmeldedatum: 09.09.2003
Eingabe(n) vom: 10.09.2003

ZUSTELLFACH



1. Vorbescheid

Die gemäß § 99 des Patentgesetzes vorgenommene Vorprüfung hat das unten stehende Ergebnis geliefert:

Das folgende, der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung zugänglich gemachte Material, wurde für die Beurteilung der Patentierbarkeit des Anmeldungsgegenstandes in Betracht gezogen. Im Deckblatt der Beschreibung (Formular PA 3 I) wären diese Entgegenhaltungen anzugeben:

- US 4 827 328 A (OZAWA et al.) 2. Mai 1989 (02.05.1989)
- US 4 839 558 A (MIERZWINSKI) 13. Juni 1989 (13.06.1989)
- WO 1997/03460 A1 (HOYA CORP) 30. Jänner 1997 (30.01.1997) (Zusammenfassung)
- EP 1 087 649 A2 (SONY CORP) 21. März 2002 (21.03.2002)

Die US 4 827 328 A zeigt die Verwendung von Dickschicht- und Dünnfilmtechnik auf einem Keramiksubstrat, in der WO 1997/03460 wird ein Glassubstrat für die Anwendung der Dünnfilm- bzw. Chip-on-board Technik verwendet.
Die anderen beiden Dokumente sind in der Beschreibungseinleitung bereits ausführlich erläutert worden.

In der Beschreibungseinleitung wären der entgegengehaltene Stand der Technik anzuführen und darzulegen, inwiefern sich der Anmeldungsgegenstand aus ihm nicht in nahe liegender Weise ergibt.

In Anspruch 2 wäre der Ausdruck „Via-Verbindungen“ durch „Durchkontaktierungen“ zu ersetzen.

In Anspruch 13 und in der Beschreibung, Seite 16, Zeile 8, wäre das Bezugszeichen „(24)“ zu entfernen, da dies in den Zeichnungen nicht enthalten ist.

Gegen die Bekanntmachung der Anmeldung auf Grund der gemäß den unverbindlichen Anmerkungen zu verbessernden Ansprüche bestehen derzeit keine Bedenken.

Es wären neue Ansprüche, eine neue Beschreibungseinleitung sowie ein neues Deckblatt in jeweils zweifacher Ausfertigung vorzulegen.